

漢測 (7856)

王子建 總經理

2026 年 08 月 26 日

免責聲明

股票名稱 漢測 7856

01

本文件及相關簡報之陳述內容係由漢民測試系統股份有限公司（下稱本公司），基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運進行彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論等所影響，容有超出本公司得以控制之部分，致實際情況或結果可能與上揭前瞻性論述未盡一致。

02

非經本公司事前書面同意，任何第三人不得基於任何目的直接或間接複製、散布、傳遞、逕行援用或擷取，或予以出版；本公司不就任何使用本文件或簡報資訊所可能導致之損害負擔任何法律責任。

風險事項

股票名稱 漢測 7856

- 產業風險
 - 半導體景氣變動激烈
 - 營運風險
 - 銷貨集中風險
 - 專業人才招聘及培育不易
 - 財務風險
 - 其他重要風險
 - 員工承購初次上櫃前現金增資發行新股之費用化金額高致影響獲利之風險
- 請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第1~3頁。

風險事項 - 補充揭露

股票名稱 漢測 7856

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月12日證櫃審字第1150101072號函要求於風險事項乙節之補充揭露事項：

貴公司提供半導體檢測設備、零組件及技術服務等，易受半導體景氣波動影響，有關貴公司面臨景氣波動及同業競爭風險、所採具體因應措施，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第4~8頁。

貴公司113年度、114年度及115年第一季銷售A公司之營業收入分別為571,514 千元、1,174,433千元及317,983千元，占整體營業收入比重分別為35.77%、48.44%及32.29%，有關銷貨集中之原因、風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第8~11頁。

有關貴公司進貨集中於甲公司、丁公司及漢民科技之原因、風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第12~19頁。

特別記載事項 - 補充揭露

股票名稱 漢測 7856

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月12日證櫃審字第1150101072號函要求於風險事項乙節之補充揭露事項：

有關貴公司業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第20~45頁。

半導體先進製程及封測技術不斷持續快速演進，高端技術研發困難度增加，有關貴公司如何吸引人才、提升研發能量及未來產品布局策略之說明，暨推薦證券商之評估意見。

請參閱風險事項及補充揭露事項說明書第45~50頁。

AGENDA

01. 公司簡介

02. 主要產品與競爭力

03. 經營實績

04. 未來成長引擎

05. ESG 永續推動

公司簡介

公司簡介

成立時間

2004.09

董事長

林冬青

員工人數 (as of July 2026)

570

總部據點

新竹市

總經理

王子建

資本額

新台幣 **2.72億元**



經營團隊



林冬青
董事長



王子建
總經理



徐文元
副總經理
市場策略與工程事業處



張菀菁
副總經理
產品事業處



廖偉三
財務長

全球營運據點 在地即時支援

漢測據點遍及台灣、中國、日本、新加坡、馬來西亞與美國，
透過在地化服務，提供客戶即時且專業的技術支援。



公司歷史沿革

2004
漢測成立

2016

- 工研院合作雷射清針項目
- 建立工程服務團隊

2020

- 建置探針卡製造產線
- 日商 MJC 技轉探針卡製造技術

2022

- 與信通交通器材共同投資成立億定材料公司，建置 MLC 產線

2025

- 漢測與日商 MJC 策略合作
- 榮獲經濟部國家產業創新獎
- 漢測興櫃登錄
- 馬來西亞、新加坡營運據點成立

2017

- 成立漢測蘇州子公司
- Hprobe 測試機推廣

2021

- 成立漢測南科分公司
- 佈局薄膜式探針卡

2023

- 成立漢測日本子公司
- 代理 Advantest 光罩量測掃描電子顯微鏡

2026

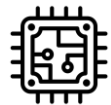
- 美國營運據點設立

主要產品與競爭力

半導體產業鏈與市場定位

聚焦晶圓測試關鍵環節，掌握 AI/HPC 帶動之測試需求

上游



IC 設計

功能描述與
技術評估

系統設計、邏輯設
計、實體設計

電路模擬、電路佈
局

Tape-out

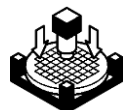


IC 製造

設計規則檢查
光罩製作

晶圓製造

中游



晶圓測試 / 先進封裝

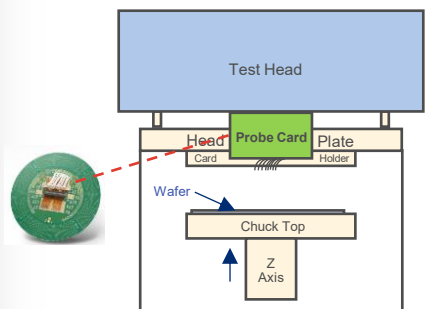
晶圓驗收測試
(WAT)

晶圓測試 (CP)

缺陷檢測

2.5D / 3D /
Chiplet

晶圓測試 (CP)



Tester 測試機
Prober 晶圓針測機

Probe Card
探針卡

下游



IC封裝測試

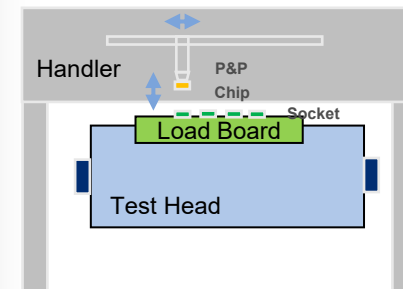
先進封裝

晶粒切割與封裝

最終測試 (FT)

可靠度測試

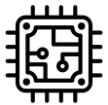
最終測試 (FT)



Tester 測試機
Load Board 測試載板
Socket IC測試座
Handler 測試分類機

漢測產品布局

上游

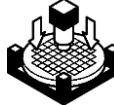


IC 設計

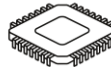


IC 製造

中游



晶圓測試

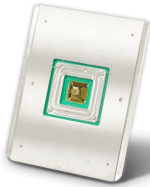


先進封裝

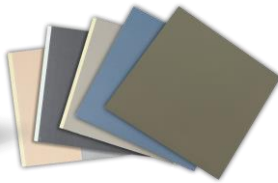


IC 封裝測試

探針卡



清潔材料



雷射清針機



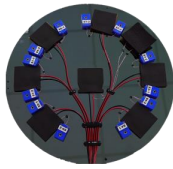
白光干涉光學
檢測系統



熱管理系統



熱載
測試系統



電子束
檢測設備



SYMPHONY
Reflow



DRAM SLT



核心產品與服務



探針卡設計製造 / 清潔材料

從探針卡到清潔材料供應，提供全方位一站式完整產品組合。



測試設備工程服務

半導體測試設備相關裝機、移機、改機、測試、維修及保養等各種專業技術服務。

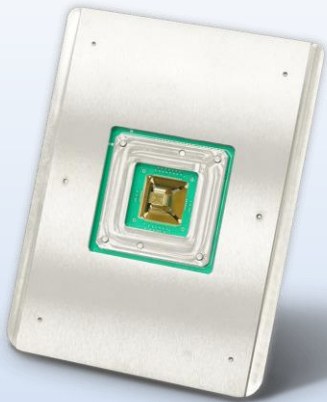


半導體設備與客製化產品

自主研發與代理雙軌並行，貼近客戶需求打造專屬解決方案。

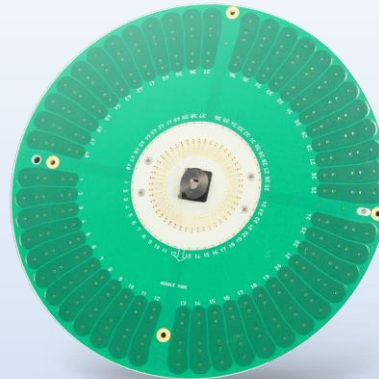
探針卡全產品線 覆蓋廣泛應用場景

薄膜式探針卡



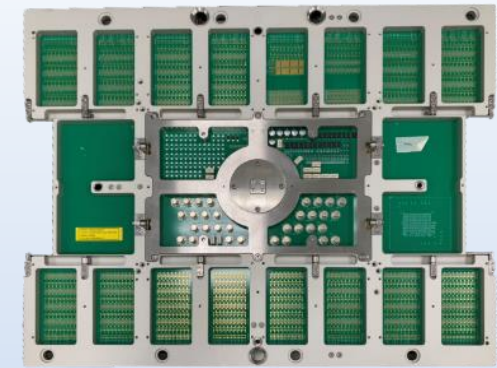
- 支援5G / 6G、RF、毫米波雷達、車用雷達晶片及濾波器等高頻測試應用
- 100% 台灣在地製造
- 獨家水平控制技術，確保測試穩定

懸臂式探針卡



- 支援WAT、Logic、LCD Driver、低階邏輯晶片、PMIC、傳統消費性電子與第三類半導體測試
- 與全球前三大探針卡MJC技轉合作
- 客製化設計，對應多元需求

垂直式探針卡



- 支援高端 SoC、GPU、AP 及 Flip Chip 封裝等高階晶片測試
- Cobra 探針卡 100% 台灣在地製造
- MEMS 探針卡與全球領導廠商 MJC 合作，結合漢測自製零組件

客製化產品

貼近客戶需求，打造客製化產品與解決方案

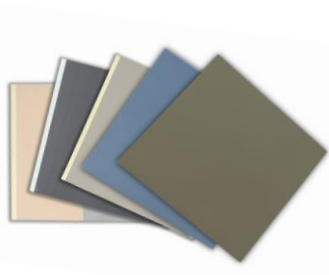
量產供應 (>20 多種產品)

開發驗證

代理設備



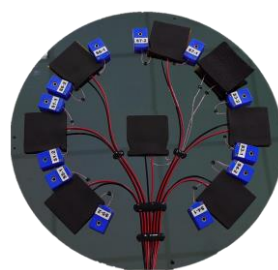
熱管理
整合系統



清潔材料



白光干涉光學
檢測系統



熱載測試系統



雷射清針機



SYMPHONY
Reflow



電子束檢測設備

核心競爭優勢

自主研發與製造實力

- 全台唯一自主研發薄膜式探針卡
- 一站式整卡解決方案能力
- 軟硬體整合測試方案

高度客製化彈性

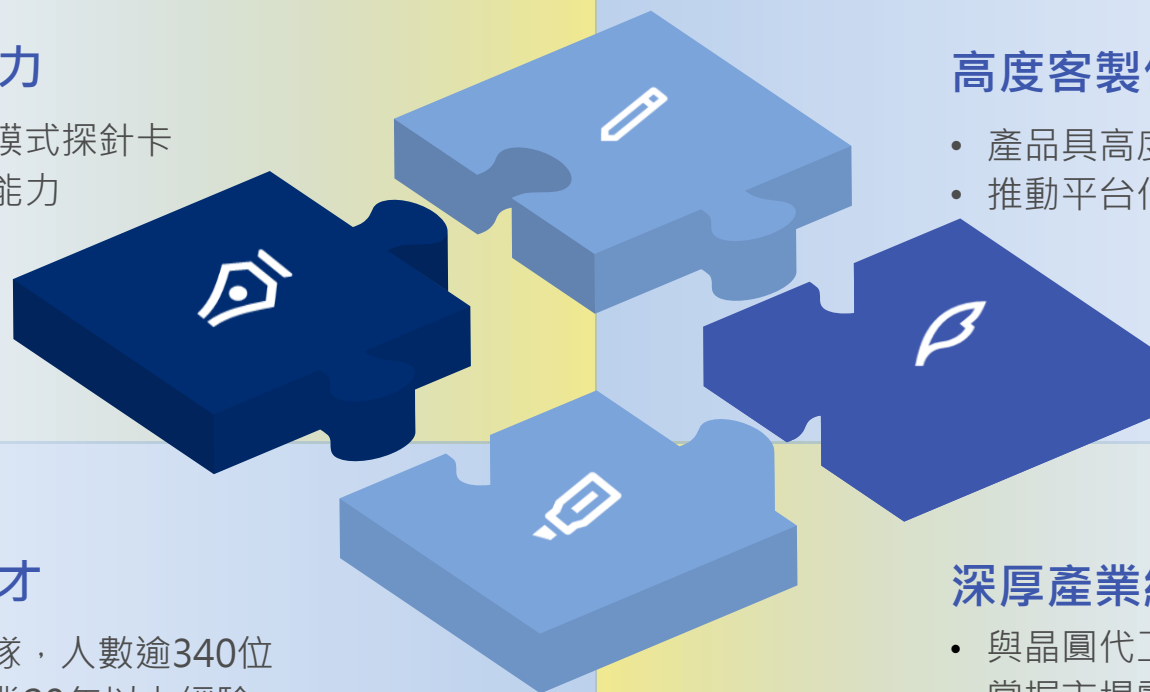
- 產品具高度客製化特性，依客戶需求快速調整
- 推動平台化與模組化設計，縮短新產品開發時程

專業團隊與技術人才

- 全台最大工程服務團隊，人數逾340位
- 高階主管具半導體產業20年以上經驗
- 研發團隊涵蓋機構、材料、電子、光學與軟體等專業

深厚產業經驗與市場連結

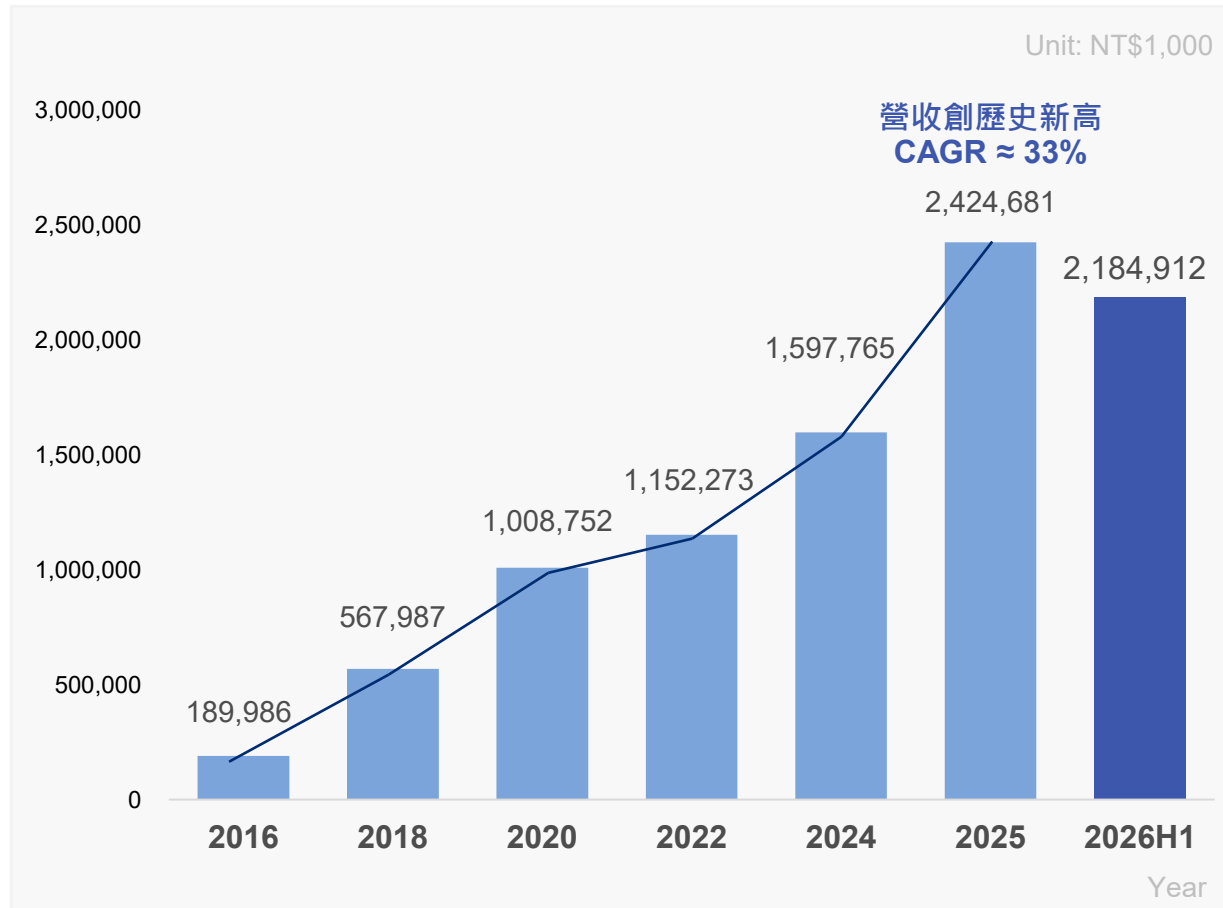
- 與晶圓代工廠、封測廠等客戶長期合作
- 掌握市場需求，強化客戶黏著度



經營實績

營業表現

2026年上半年營收達21.85億元，已達2025年全年營收約九成；2026年7月營收4.83億元，月增11.22%、年增220.69%；累計前7月累計營收新台幣26.68億元，年增128.18%，已超越2025年全年營收24.25億元。



	2024	2025	2026H1
營業收入	1,597,765	2,424,681	2,184,912
營業毛利	578,908	1,020,814	1,199,125
毛利率	36.23%	42.10%	54.88%
營業利益	53,550	296,601	733,972
營業利益率	3.35%	12.23%	33.59%
稅後淨利	56,765	268,333	584,198
稅後EPS	2.84	10.83	21.5

未來成長引擎

AI 驅動先進封裝演進 晶片複雜度與測試需求同步提升

1

市場驅動因素



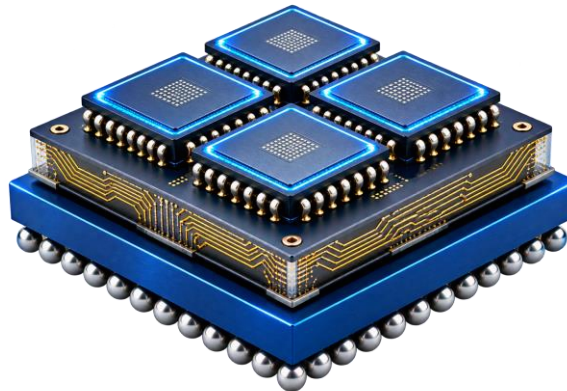
AI · LLMs · Cloud



運算需求快速成長

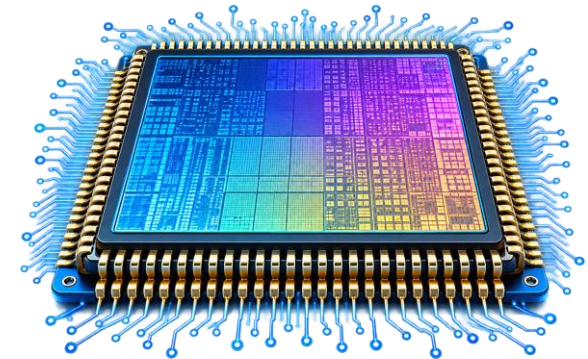
2

架構演進

Monolithic SoC → 2.5D / 3D Integration
Chiplets · CoWoS · HBM

3

複雜度提升



Trillion-Transistor Era

Higher Test Complexity
Large Die · Dense Interconnects**More Compute → Advanced Packaging → More Complex Testing**

先進晶圓測試關鍵挑戰

當先進封裝與高階晶片持續發展，測試面臨的不只是單一技術挑戰，而是機構、熱、光、電與材料等多面向整合問題。

Large P/C Handling 超重探針卡穩定承載

Handle larger and heavier packages with stability



Inspection 高精度缺陷檢測

Detect defects with higher precision



Warpage Wafer Control 晶圓吸附與接觸穩定性

Control adhesion and surface interactions.



Thermal 高功耗熱管理

Manage heat for stable, reliable test performance.



Optical 光學對位與訊號完整性

Achieve precise optical alignment



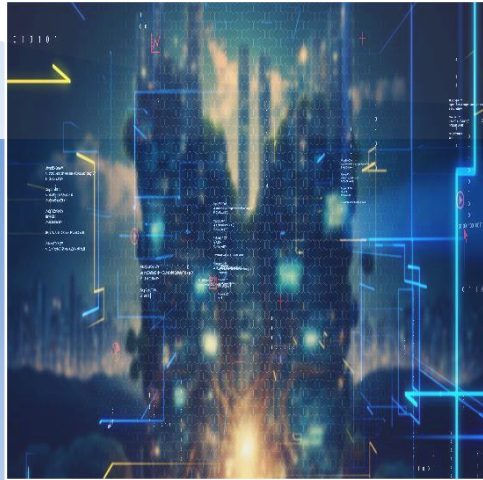
Transmission 高頻寬、低損耗訊號傳輸

Enable high-bandwidth, low-loss transmission

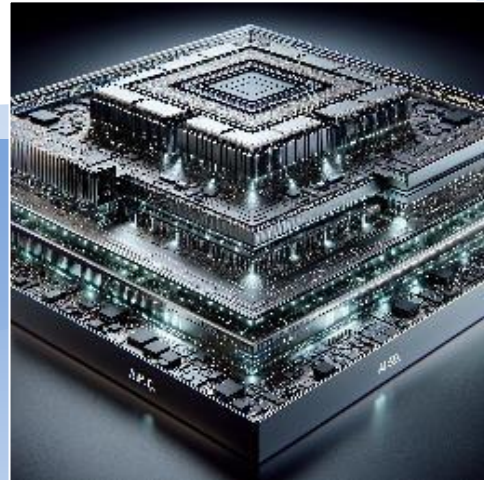


漢測未來成長引擎

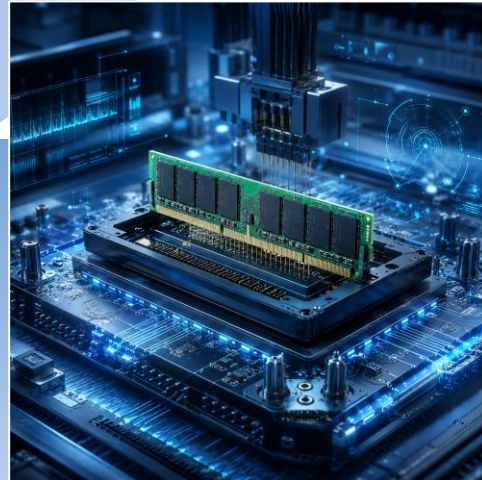
聚焦高階測試需求，拓展四大成長應用



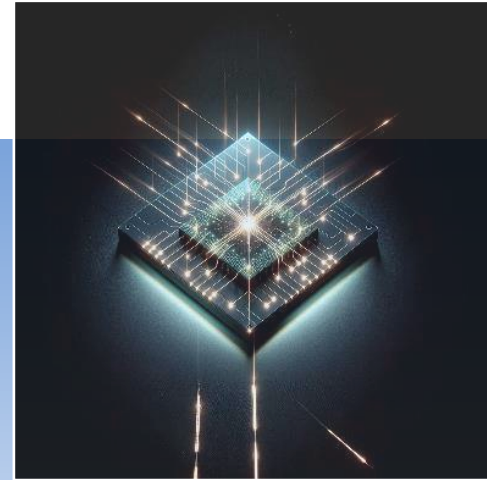
高功耗熱管理
整合方案



先進封裝設備
應用布局



高速記憶體SLT
測試整合方案



矽光子與CPO

高功耗熱管理整合方案

核心效益

提升測試散熱效率

快速帶走高功耗測試所產生的熱能

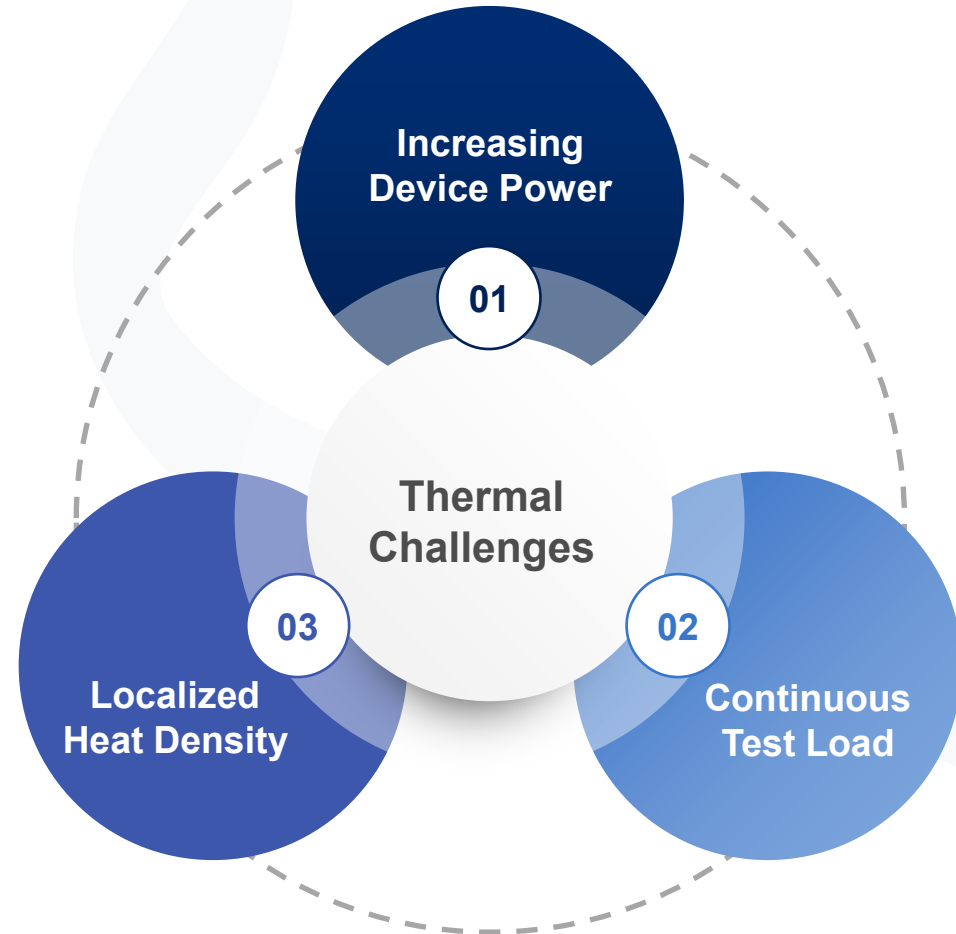
提升高功耗測試穩定性

降低熱累積造成的測試異常與誤判

降低燒針風險

延長探針卡壽命

改善高溫環境下的接觸可靠度



*Effective Thermal Management Is Essential for
Reliable High-Power Testing*

**Source: SWTEST 2026 Report*

先進封裝設備應用佈局

SYMPHONY Fluxless Reflow Solution

切入 Wafer Bumping 與 CoWoS 關鍵製程，掌握 AI / HPC 帶動的先進封裝設備需求。

Wafer Bumping

- C4 Bump
- Micro Pillar
- Copper Pillar
- 支援 150/200/300mm 晶圓

CoWoS 先進封裝製程

- Chip-to-Wafer Temporary Bonding 後段製程
- Fluxless Reflow 無助焊劑回焊
- Flux Reflow 助焊劑回焊
- 適用高密度、高凸塊數及大尺寸封裝應用



精準溫控 | 低氧製程 | 可控冷卻 | 即時監控 | 高均勻性

高速記憶體 SLT 測試整合方案

隨 DDR5 / DDR6 高速記憶體需求持續成長，漢測積極跨入 DRAM SLT 測試，並開發支援 15G bps 以上傳輸速率的高速測試座。

DRAM SLT Tester

- 系統級功能與可靠度驗證
- 支援高速記憶體量產測試
- 提升潛在缺陷篩選能力

高速測試座

- 高速訊號傳輸與穩定接觸
- 依 DUT 與測試條件客製化
- 提供在地導入、維護與技術支援



矽光子 CPO 測試方案



Insertion 1
急速對位耦光方案
HTSI TestMate Integration



Insertion 2
OEM Manufacturing /
ODM Customized Module

ficonTEC
photronics assembly & testing



Insertion 3
Technical Support &
Service

ficonTEC
photronics assembly & testing

ESG 永續推動

ESG 永續推動

成立永續發展委員會，負責執行及推動公司永續發展之治理；
2026年編製完成首本ESG報告書。

公司治理

- 擁有32件專利，核准註冊商標共6件
- 董事會運作與獨立性
 - 獨立董事席次已逾1/3
 - 董事會性別多元
- 落實誠信經營
- 各項財務揭露於官網

環境保護

- 參與苗木培育志工活動
- 依循ISO 14064-1執行溫室氣體盤查
- 廢汙水排放及空氣汙染排放管理
- 垃圾分類與資源回收

社會責任

- 投入志工假支援花蓮救災
- 捐贈社區服務車
- 參與食物銀行志工活動
- 不定期舉辦AED實際操作講座
- 提供員工團保及員工健檢
- 實行特殊健康檢查

HTSI

漢民測試
Hermes Testing

THANKS

